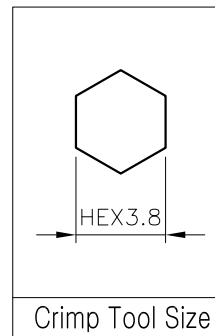
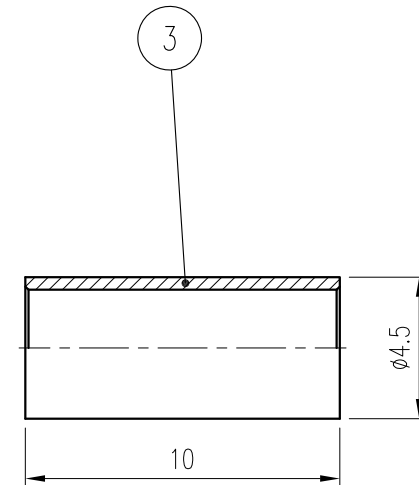


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
IR	초도작성			2004. 05. 06.
1	[실변처리No.201201-0011] BODY 내부 변수배열 추가	김인철	윤재호	2012. 02. 01.
2	[실변No.201806-0004] 조립성 개선으로 인한 공응화 치수 변경	은선영	김인철	2018. 06. 08.
3	구성 핀 코드 변경 - 내경 $\phi 0.7$	김선호		2023. 10. 13.



2	7	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1
	6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00101-N/4 DN00101-N/4
	4	PACKING	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
	3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFF00043-5/1
3	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCI00292-5/1 DCI00291-5/4
1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00135-5/1

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 소수 각도 분수 ±0.1 ±1°	년월일 2023. 10. 13.	승인		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
재질	검도					
열처리	제도	S. H. KM				
보호피막처리	작성부서	인구소		A4	도번	CN00901-7/1
	적도 4/1	단위 mm	중량			K314-001-200